

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】令和6年11月6日(2024.11.6)

【国際公開番号】WO2024/121910
【出願番号】特願2023-540959(P2023-540959)

【国際特許分類】

H 0 1 L 2 1 / 6 8 3 (2 0 0 6 . 0 1)

【 F I 】

H 0 1 L 2 1 / 6 8

N

10

【手続補正書】

【提出日】令和5年7月4日(2023.7.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

[3] 上述した半導体製造装置用部材(前記[1]又は[2]に記載の半導体製造装置用部材)において、前記プラグ配置穴の内周面の仰角及び前記プラグの外周面の仰角は、55°以上85°以下であることが好ましい。こうすれば、プラグ配置穴の内周面とプラグの外周面との間に接着層を設ける際、接着剤が均一に広がりやすいため、接着層に気泡が生じないかほとんど生じない。そのため、プラグの周辺(接着層)での放電を防止する効果が高まる。

20

30

40

50